

9/7/4

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05180736

METHOD FOR SIMULATING \*SHAPE\*

PUB. NO.: 08-136236 [JP 8136236 A]

PUBLISHED: May 31, 1996 (19960531)

INVENTOR(s): SANHONGI SHOJI

INOUE SOICHI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP  
(Japan)

APPL. NO.: 06-273534 [JP 94273534]

FILED: November 08, 1994 (19941108)

#### ABSTRACT

PURPOSE: To provide a method for simulating \*shape\* by which the \*two\*- and three-\*dimensional\* \*shapes\* of a resist after development can be calculated with accuracy in a short time.

CONSTITUTION: In a method for simulating \*shape\* by which the developed surface \*shape\* of a resist which is formed on a substrate and exposed in a desired pattern is predicted, a plurality of points on the surface of the undeveloped resist is used as starting points and the points are moved in the \*vertical\* direction 12 which is perpendicular to the surface of the substrate from the surface of the resist. The moving directions of the points are switched from the \*vertical\* direction 12 to \*horizontal\* directions 13 and 14 which are parallel to the surface of the substrate at every point in the direction 12 and the moving loci of the points in both the \*vertical\* and \*horizontal\* directions are found as the routes of the points. Then the developed \*shape\* of the resist is obtained by calculating the envelopes of all routes.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-136236

(43) 公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

G 0 1 B 11/24

G 0 3 F 7/26

G 0 6 F 17/00

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

Z

5 0 1

9069-5L

G 0 6 F 15/ 20

D

H 0 1 L 21/ 30

5 6 9 F

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 7 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願平6-273534

(22) 出願日

平成6年(1994)11月8日

(71) 出願人 00003078

株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72) 発明者 三本木 省次

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(72) 発明者 井上 壮一

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

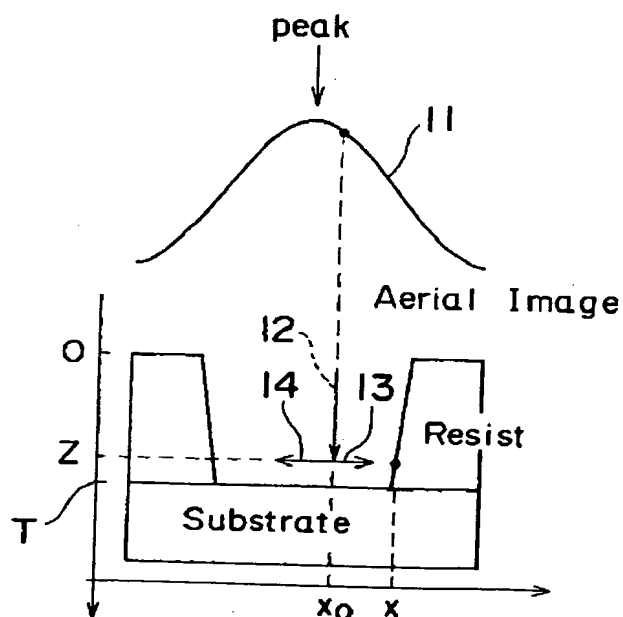
(74) 代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54) 【発明の名称】 形状シミュレーション方法

(57) 【要約】

【目的】 短い計算時間で、現像によるレジストの2次元及び3次元形状を正確に計算することのできる形状シミュレーション方法を提供すること。

【構成】 基板上に形成され所望パターンに露光されたレジストを現像処理することにより変化する該レジスト表面の形状を予測する形状シミュレーション方法において、現像前のレジスト表面の複数の点を始点として、これらの点を表面から基板に垂直な方向12に移動し、基板に垂直な方向12の全ての点で移動方向を基板に垂直な方向から基板に水平な方向13、14に切り替え、現像終了時間に到達するまで基板に垂直又は水平な方向に移動した軌跡を経路とし、全ての経路についての包絡線を取り現像後の形状とする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】基板上の被加工膜の表面を物理的又は化学的に加工することにより変化する該表面の形状を予測する形状シミュレーション方法において、

加工前の前記被加工膜表面上の複数の点を代表点とし、これらの代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に垂直な方向に移動させる第1工程と、前記代表点の移動方向を前記基板に垂直な方向から前記基板に水平な方向に切り替える第2工程と、前記代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に水平な方向に移動させる第3工程と、任意の加工時間において第1工程から第3工程を経て移動した該代表点の軌跡を経路とし、前記全ての経路についての包絡線又は包絡面をとり前記加工後の形状とする第4工程とを含むことを特徴とする形状シミュレーション方法。

【請求項2】前記基板に水平な方向を、前記基板に水平な面内に成す角が互いに180°である2方向にとることを特徴とする請求項1記載の形状シミュレーション方法。

【請求項3】前記基板に水平な方向として、前記基板に水平な面内に隣合う方向の成す角が等しい方向を8方向以上とることを特徴とする請求項1記載の形状シミュレーション方法。

【請求項4】前記被加工膜は、所望パターンに露光された感光性樹脂層であることを特徴とする請求項1記載の形状シミュレーション方法。

【請求項5】基板上に形成され所望パターンに露光された感光性樹脂層を現像処理することにより変化する該感光性樹脂層表面の形状を予測する形状シミュレーション方法において、

前記現像処理前の前記感光性樹脂層表面上の複数の点を代表点とし、これらの代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に垂直な方向に移動させる第1工程と、前記代表点の移動方向を前記基板に垂直な方向から前記基板に水平な方向で、かつ前記基板に水平な面内に隣合う方向の成す角が等しい8方向以上に切り替える第2工程と、前記代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に水平な方向に移動させる第3工程と、任意の加工時間において第1工程から第3工程を経て移動した該代表点の軌跡を経路とし、前記全ての経路についての包絡線又は包絡面をとり現像処理後の形状とする第4工程とを含むことを特徴とする形状シミュレーション方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、形状シミュレーション方法に係わり、例えば半導体素子等をリソグラフィ工程で製造する際の、現像液によるレジストの溶解による形状変化等を予測する場合に適した形状シミュレーション方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】半導体素子等をリソグラフィ工程で製造する場合には、レジスト（感光性樹脂層）が塗布されたウェハ上にマスクパターンの像を投影した後、そのウェハを現像することにより、例えばポジレジストであれば露光量の多い部分のレジストが現像液により溶解し、レジストパターンが形成される。現像後のレジストパターンは、マスクパターンの像を投影する際のウェハのデフォーカス状態、露光条件（開口絞り、コヒーレンスファクタ、光源形状、瞳フィルタ等）、現像時間、さらにはマスクパターンそのものによって種々に変化する。従って、所定の焦点深度を持つように所望パターンを仕上げるための投影光学系の条件及びマスクパターンを実験で求めるには、膨大な数の露光実験を行わなければならない。

【0003】そこで、コンピュータによるシミュレーションによって、現像後のレジスト形状を予め最良の状態となる条件を求めておくことが望ましい。このように現像後のレジスト形状を予測する手法は、レジスト形状シミュレーションとして知られている。

【0004】従来のレジスト形状シミュレーションの方法としては、種々の方法が提案されている。以下に、これらを簡単に説明する。2次元的な形状のみを扱う場合にはレジストの形状を微小線分の連なりで、3次元的な形状を扱う場合にはレジストの形状を微小面素の連なりで表現し、微小線素又は微小面素の移動する方向は表面に垂直な方向とするストリング・モデルがある。これに対して、移動方向を光線の微分方程式と同様な微分方程式を解いて求める手法は、レイ・トレーシング・モデルと呼ばれる。

【0005】物体を微小なセルの集合体に分割し、物体表面におけるセルの消失又は付着により形状変化を表現する手法であるセル・モデルも知られている。また、特開平6-176997号公報に示されているように、物体形状を分布関数の等値面で表し、形状の時間変化を拡散方程式に類似した微分方程式を解くことによって求める分布関数法もある。

【0006】さらに、簡易的な方法ではあるが現像のプロセスをレジスト表面の最も溶解速度の速い点を始点として、基板に垂直な方向に現像が進み、ある距離進んだ点から基板に水平な方向に現像が進み、現像方向を切り替える点を基板に垂直な全ての点で起こるとして、終点の集合を現像後の形状とする簡易現像モデルも知られている。

【0007】しかしながら、この種の方法にあっては次のように問題があった。即ち、ストリング・モデルやレイ・トレーシング・モデルを用いると、微小線分又は微小面素がループを形成してしまう場合があり、ループの削除を行う必要がある。ところが、3次元に拡張されたモデルでは、膨大な数の微小面素に対してループの有無を調べなければならない、極めて複雑なアルゴリズムとな

る上に、計算コストも大幅に増大するという不都合があった。

【0008】また、セル・モデルでは、セルの辺に対して斜め方向の形状をうまく表現できない。さらに、表面に露出したセルの面の数に応じて移動速度を補正する必要があるが、この際に物理的意味が明確なモデルを作することは困難であるため、信頼性に欠けるという不都合があった。

【0009】また、分布関数法では、物体表面の移動を熱伝導問題等で現れる拡散方程式を修正することによって、実際の物理現象と対応しているため精度良く計算できるが、計算コストが極めて大きく、投影光学系の条件やマスクパターンの最適化には不都合であった。

【0010】また、簡易現像モデルでは、物体表面の移動の始点と移動方向の限定があり計算コストは他のモデルに比べて格段に小さいが、限定が強すぎるために精度が悪い場合があるという不都合があった。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】このように従来、レジストの形状シミュレーション方法としては各種の方式が提唱されているが、いずれの方式も計算コストと精度の両方を満足することはできなかった。例えば、分布関数法は精度的には最も優れるものの計算コストが大きく、簡易現像モデルは計算コストの点では最も優れているものの精度が悪い問題があった。

【0012】本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、その目的とするところは、少ない計算時間で2次元及び3次元の被加工膜の形状をある程度正確に予測できる形状シミュレーション方法を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために本発明は、次のような構成を採用している。即ち本発明は、基板上の被加工膜の表面を物理的又は化学的に加工することにより変化する該表面の形状を予測する形状シミュレーション方法において、加工前の前記被加工膜表面上の複数の点を代表点とし、これらの代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に垂直な方向に移動させる第1工程と、前記代表点の移動方向を前記基板に垂直な方向から前記基板に水平な方向に切り替える第2工程と、前記代表点をそれぞれの加工速度に応じて前記基板に水平な方向に移動させる第3工程と、任意の加工時間において第1工程から第3工程を経て移動した該代表点の軌跡を経路とし、前記全ての経路についての包絡線又は包絡面をとり前記加工後の形状とする第4工程とを含むことを特徴とする。

【0014】ここで、本発明の望ましい実施態様としては、次のものがあげられる。

(1) 基板に水平な方向を、前記基板に水平な面内に成す角が互いに180°である2方向にとること。

(2) 基板に水平な方向を、基板に水平な面内に隣合う方向の成す角が等しい方向に8方向以上とること。

(3) 被加工膜として所望パターンに露光された感光性樹脂層を用い、この感光性樹脂層を加工する処理として現像処理を行うこと。

(4) 被加工膜はその表面に所望パターンのエッチングマスクが形成され、被加工膜を加工する処理として、ウェットエッチングを行うこと。

【0015】

【作用】本発明によれば、現像等による加工の始点を被加工膜表面の複数の点にとり、加工の進むべき方向を基板に垂直な方向と水平な方向に限定し、複数の点の軌跡を経路とし全ての経路についての包絡線又は包絡面をとることにより、被加工膜の加工後の形状を正確に予測することができる。そしてこの場合、加工の進むべき方向を基板に垂直な方向と水平な方向に限定しているので、非常に少ない計算時間で済ませることができる。より具体的には、従来の簡易現像モデルと差ほど変わらない計算コストで、従来の分布関数法と同等若しくはそれに近い精度を得ることが可能となる。

【0016】

【実施例】以下、本発明の詳細を図示の実施例によって説明する。

(実施例1) 図1から図4は、本発明の第1の実施例に係わるレジストの形状シミュレーション方法を説明するための図である。図1は、レジストを露光・現像する際における空間像及び現像方向を示す模式図である。11は空間像、12は垂直方向の現像方向、13、14は水平方向の現像方向を示している。

【0017】まず、マスクパターンの投影光学系透過後の空間像11を計算する。ここで、膜厚方向の光強度分布変化はなく、z方向での光強度分布は空間像11に等しいとする。

【0018】次いで、図2に示すレジストの溶解特性を表わす溶解速度曲線に従って、レジスト中の溶解速度分布 $R(x, z)$ を求める。現像前のレジストの表面各点 $(x = x_0, z = 0)$ から現像を膜厚方向(z方向)12に進める。このとき、膜厚方向にzだけ現像を進めるのに要する時間 $t_1$ は次式で与えられる。

【0019】

【数1】

$$t_1 = \int_0^z dz' / R(x_0, z')$$

【0020】膜厚方向にzだけ現像を進めた後、基板に水平な方向に現像を進める。このとき、図1の13及び14のように互いに成す角180°の方向の2方向に現像を進める。このとき $x = x_0$ から $x = x'$ まで現像が進むのに要する時間 $t_2$ は次式で与えられる。

【0021】

【数2】

$$t_2 = \int_{x_0}^{x'} dx / R(x, z)$$

【0022】次に、 $t_1 + t_2$  を一定（現像時間）とするような経路を全ての始点、現像方向を切り替える点を  $z=0$  から  $z=T$  の全ての点にとったものに対して求める。全ての経路に対する包絡線が現像後のレジスト形状を示している。

$$\frac{\partial C(x, y, z, t)}{\partial t} + R(x, y, z) |\nabla C(x, y, z, t)| = 0$$

【0025】また、比較のために、現像の始点を溶解速度の最も大きい点に限定した場合（簡易現像モデル）の現像時間を10秒刻みで変えた結果を図3（a）に破線で示し、分布関数モデルでの結果を図3（a）に実線で示す。

【0026】また、大パターン（露光波長365nm、開口数0.5、コヒーレンスファクタ0.6、輪帯遮蔽率0.67、 $1.0 \mu\text{mL}/\text{S}$ ）での現像時間を5秒刻みで変えた結果を、図4に示す。図4（a）（b）で実線は分布関数モデルでの結果で、図4（a）の破線は簡易現像モデルでの結果で、図4（b）の破線は本実施例方法での結果である。

【0027】現像時間の小さい場合や大パターンの場合には、簡易現像モデルは分布関数モデルからのずれが大きい。これに対して、本実施例方法による結果は分布関数モデルと良く合う。特に、基板上での仕上がり寸法の誤差は1%以下でかなり良い一致を示している。

【0028】また、 $z=T$  の場合のみを計算することによって、レジストの解像寸法だけを算出することも可能である。また、本実施例では、光強度分布は膜厚方向で一定であると仮定しているが本発明を限定するものではなく、デフォーカス、下地からの反射等によるレジスト膜方向の光強度分布を計算しても、本発明を逸脱するものではない。

【0029】このように本実施例方法によれば、非常に短時間で現像後のレジスト形状を正確に計算することができる。即ち、従来の簡易現像モデルと差ほど変わらない計算コストで、従来の分布関数法と同等若しくはそれに近い精度を得ることができる。このため、所定の焦点深度を持つように所望パターンを仕上げるための露光条件及びマスクパターンを高速に求めることが可能となる。

（実施例2）次に、図5から図7を用いて本発明の第2の実施例を説明する。本実施例は、図5（a）（b）に示すような2次元的なマスクパターンによるレジスト形状を算出する方法に関する。

※50

※【0023】小パターン（露光波長365nm、開口数0.5、コヒーレンスファクタ0.6、輪帯遮蔽率0.67、 $0.35 \mu\text{mL}/\text{S}$ ）に対する現像時間を10秒刻みで変えた結果を、図3（b）に破線で示す。比較のために分布関数  $C(x, y, z, t)$  を用いて、次式を解き等値面を求めた（分布関数モデル）結果を、図3（b）に実線で示す。但し、現像時間を10秒刻みで変えた結果を示す。

【0024】

【数3】

※【0030】図5（a）（b）のマスクパターンによる2次元的な空間像を計算する。ここで、図5（a）では、露光波長365nm、開口数0.63、コヒーレンスファクタ0.54、輪帯遮蔽率0.0の繰返しパターンとする。図5（b）では、露光波長365nm、開口数0.57、コヒーレンスファクタ0.6、輪帯遮蔽率0.0の繰返しパターンとする。

【0031】第1の実施例と同様に、レジストの膜厚方向の光強度分布は無視し、膜厚方向で光強度分布は一定であるとする。前記図2の溶解速度特性から、溶解速度分布を求める。現像前のレジストの表面の全ての点から現像を開始し、第1の実施例と同様に始めは膜厚方向、次いで基板に水平な方向に現像を進め、包絡線を求める。

【0032】基板に水平な方向は、無限に多く存在するが、図6に示すように放射状に等角に4方向（a）、8方向（b）、16方向（c）にとる。それらの  $z=T$  の場合の結果と分布関数による結果をそれぞれ重ねて、図7に示す。

【0033】図7中の破線が本実施例による結果であり、外側の実線が分布関数モデルによる結果である。図7（a）は4方向、（b）は8方向、（c）は16方向であり、7aA、7bA、7cAはマスクパターンAによるボトムでのレジストの界面、7aB、7bB、7cBはマスクパターンBによるボトムでのレジストの界面である。

【0034】図7（a）では、分布関数モデルによる結果と本実施例による結果とが僅かにずれている。しかし、図7（b）（c）では、分布関数モデルによる結果と本実施例による結果が一致しており、破線及び実線が重なっている。つまり、水平方向を8方向以上とることによって、分布関数による結果と非常に良く一致するのが分かる。

【0035】また、 $z=T$  の場合のみを計算することによって、レジストの解像寸法だけを算出することも可能である。また、本実施例では、光強度分布は膜厚方向で

一定であると仮定しているが本発明を限定するものではなく、デフォーカス、下地からの反射等によるレジスト膜方向の光強度分布を計算しても、本発明を逸脱するものではない。

【実施例3】次に、図8及び図9を用いて、本発明の第3の実施例方法を説明する。ここでは、図8に示すように膜厚方向の溶解速度分布が大きいレジストでの計算方法を述べる。

【0036】ボトムの上上がり寸法のみを計算する場合には、基坂まで到達しない場合は抜き寸法は零と考えればよく、計算では基坂に到達する場合だけを考える。基坂まで到達するのに必要な時間 $t_r$ は、

【0037】

【数4】

$$t_r = \int_0^T dz / R(x, z)$$

であるから、溶解速度分布 $R(x, z)$ を膜厚方向で平均化したもの

【0038】

【数5】

$$R_{ave}(x) = T / t_r$$

で置き換えることができる。また、水平方向に進む現像ではボトム付近での溶解速度 $R_{bottom}(x)$ を用いる。

【0039】図9に、 $0.25\mu m L/S$ パターンの露光結果（露光波長 $365nm$ 、開口数 $0.5$ 、コヒーレンスファクタ $0.5$ 、輪帯遮蔽率 $0.0$ ）と計算結果を示す。この図から、実験結果とシミュレーション結果（露光量 $38mJ$ ）とが非常に良く一致しているのが分かる。

【0040】なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではない。実施例では光リソグラフィにおけるレジストの溶解現象を示したが、本発明は光リソグラフィに限るものではなく、電子線リソグラフィ又はX線リソグラフィ等での、照射強度と溶解速度との関係の知られているレジストの溶解現象にも適用できる。

【0041】また、被加工膜は必ずしもレジストに限るものではなく、ウェットエッチングにより加工される薄膜であってもよい。この場合、被加工膜のマスクパター

ン開口に露出した部分のエッチング速度が、面内方向の各位置で分かっているものであればよい。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。

【0042】

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、加工の始点を被加工膜表面の複数の点にとり、加工の進むべき方向を基板に垂直な方向と水平な方向に限定し、複数の軌跡を経路とし全ての経路についての包絡線をとることにより、少ない計算時間で2次元及び3次元の被加工膜の形状をある程度正確に予測できる形状シミュレーション方法を実現することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施例を説明するためのもので、レジストを露光・現像する際における空間像と現像方向を示す模式図。

【図2】第1の実施例で用いるレジストの溶解速度曲線を示す図。

【図3】現像後時間に対する包絡線パターンを実施例と従来例と比較して示す図。

【図4】現像後時間に対する包絡線パターンを実施例と従来例と比較して示す図。

【図5】第2の実施例で用いたマスクパターン形状を示す図。

【図6】第2の実施例において選択した基板に水平な方向を示す図。

【図7】第2の実施例における包絡線パターンを示す図。

【図8】第3の実施例で用いたレジストの溶解速度曲線を示す図。

【図9】第3の実施例におけるパターン露光結果と計算結果を示す図。

【符号の説明】

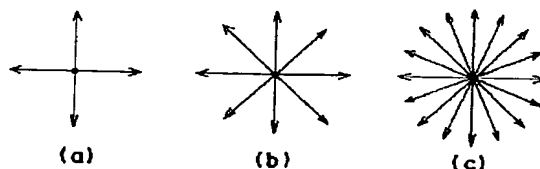
11…空間像

12, 13, 14…現像方向

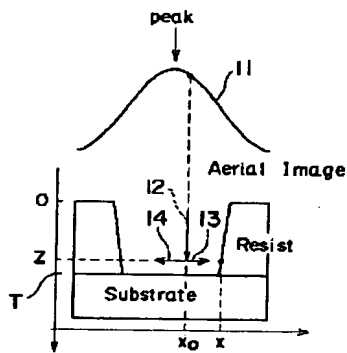
7aA, 7bA, 7cA…マスクパターンAによるボトムでのレジストの界面

7aB, 7bB, 7cB…マスクパターンBによるボトムでのレジストの界面

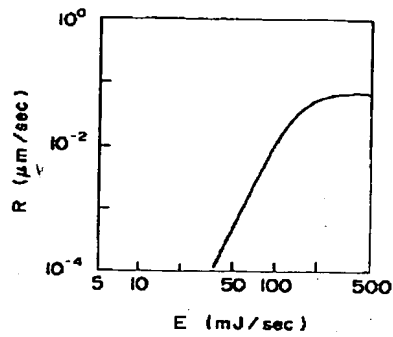
【図6】



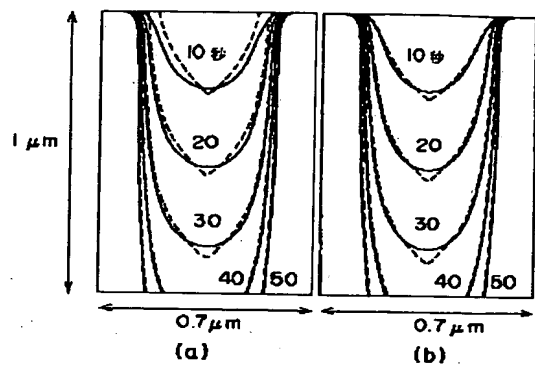
【図1】



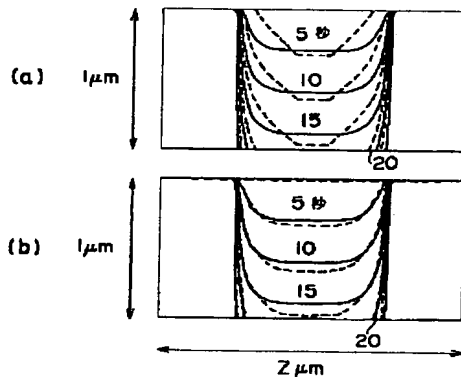
【図2】



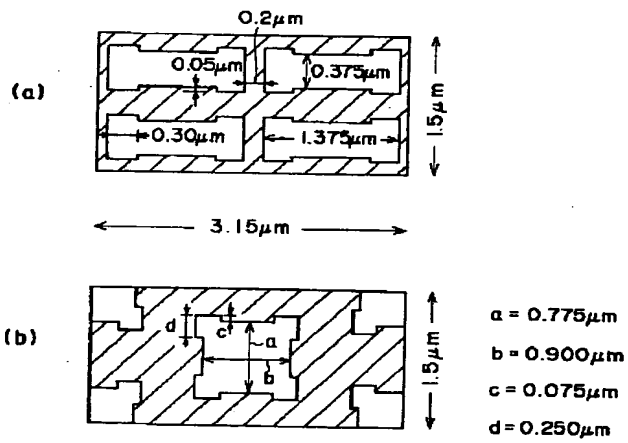
【図3】



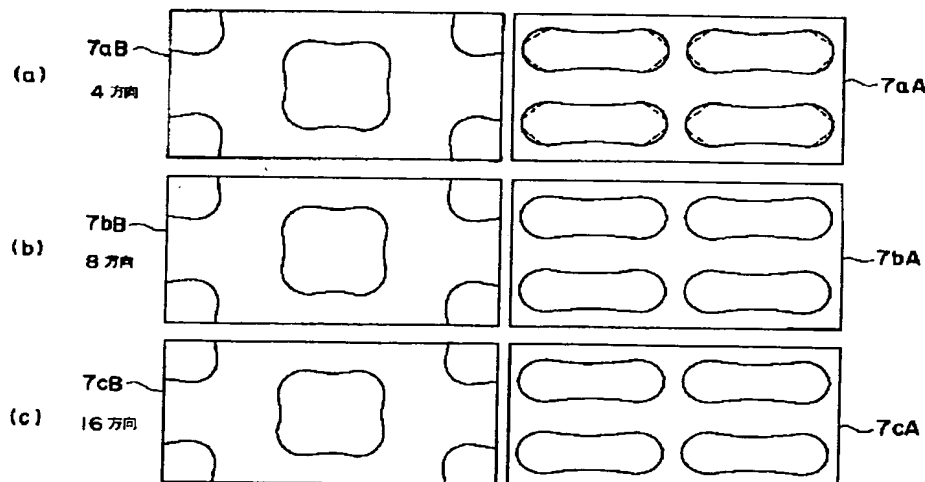
【図4】



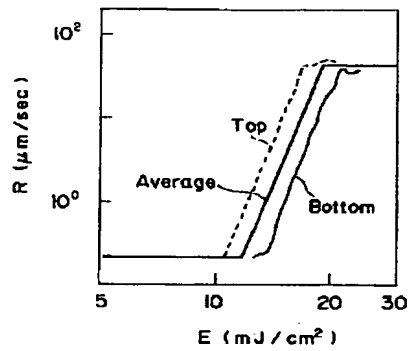
【図5】



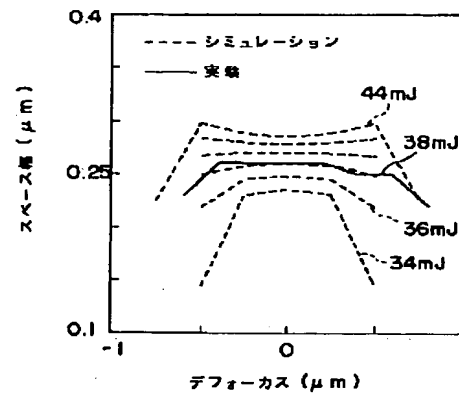
【図7】



【図8】



【図9】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

H01L 21/027

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所